

atect

決算説明資料

2010年3月期第2四半期

atect

JASDAQ
Listed Company 4241

2009年10月
株式会社アテクト
IR担当

第1部 2010年3月期 第2四半期概要

P3

第2部 配当政策

P19

第3部 参考資料

P21

IRカレンダー

P26

第1部

atect

第2四半期概要

[連結]

期中における半導体の急回復-----【16億84百万円】

計画18億99百万円／前年同期比 $\Delta 20.6\%$

営業利益--- 【30百万円】

計画53百万円／前年同期 103百万円

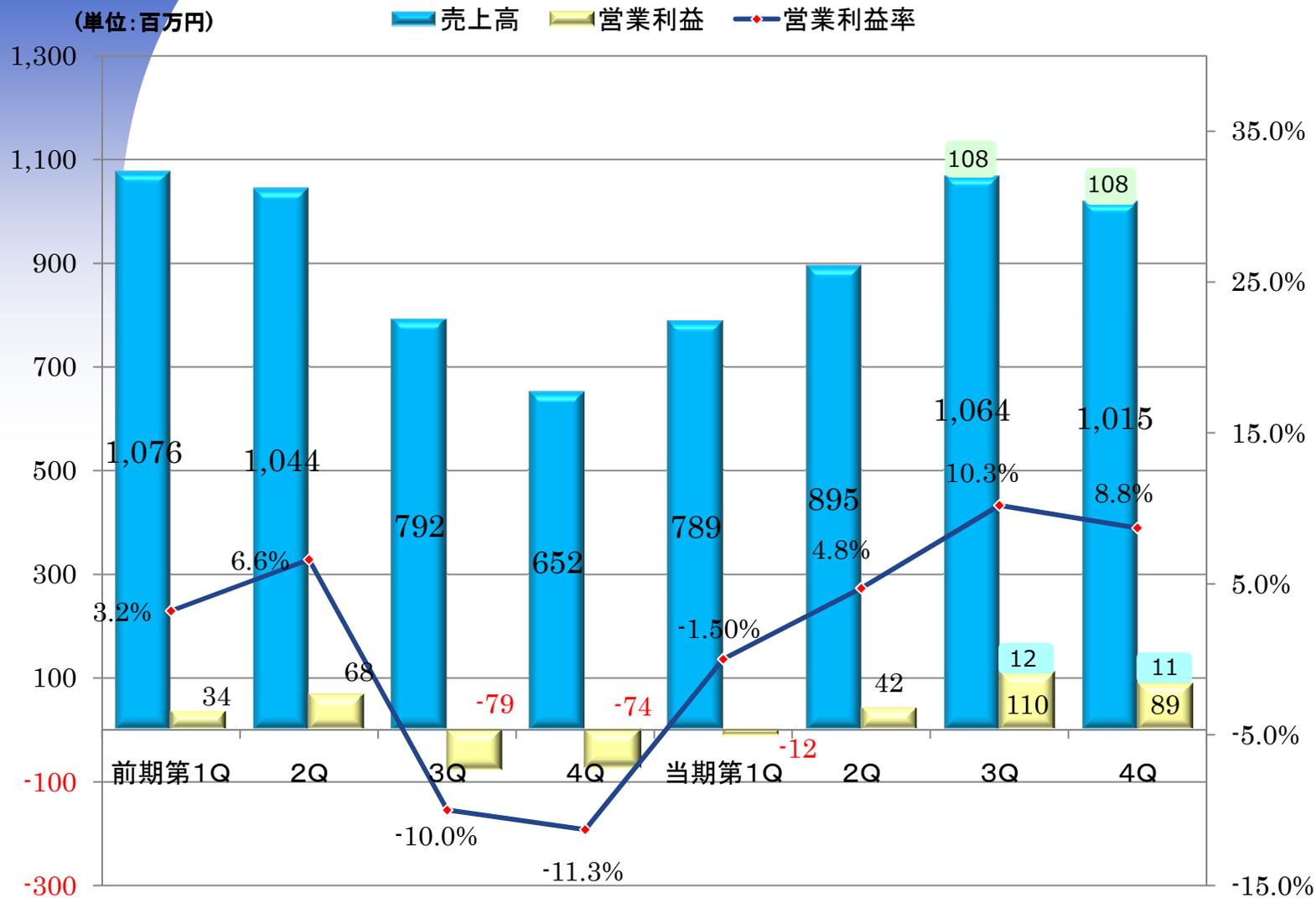
- ① 半導体資材事業 : 計画比 $\Delta 1.5\%$ ／前年同期比 $\Delta 29.6\%$
パネルメーカーの高稼働に伴う6月の急回復後、
安定的に売り上げが推移。
- ② 衛生検査器材事業 : 市況悪化の中も安定的に推移。
(営業利益90百万円)
- ③ プラスチック造形事業 : 液晶パネル製造ライン用製品の出荷遅延。
- ④ ポリマー微粒子事業 : 国内自動車メーカーの開発見送り。

(単位:百万円)

	09年3月期 第2四半期 (個別)	10年3月期 第2四半期 (個別)	前期比 (個別)	10年3月期 第2四半期 (既存事業)	09年3月期 第2四半期 (連結)	10年3月期 第2四半期 (連結)	前期比 (連結)
売上高	1,814	1,546	△14.7%	1550	2,120	1,684	△20.6%
売上総利益	591	540	△8.5%	547	633	534	△15.6%
(粗利益率)	(32.6%)	(35.0%)		(35.3%)	(29.9%)	(31.7%)	
(販管費比率)	(22.9%)	(26.2%)		(26.1%)	(25.0%)	(29.9%)	
営業利益	175	136	△22.5%	142	103	30	△70.4%
(営業利益率)	(9.7%)	(8.8%)		-	(4.9%)	(1.8%)	
経常利益	168	120	△28.3%	-	84	13	△83.6%
(経常利益率)	(9.3%)	(7.8%)		-	(4.0%)	(0.8%)	
四半期純利益	85	58	△31.4%	-	5	△49	-

利益動向-四半期推移

営業利益率：半導体資材事業の受注回復に伴い改善



(単位:百万円)

	09年3月期 期末 (連結)	構成比 %	10年3月期 第2四半期 (連結)	構成比 %	直前期比 %
流動資産	1,931	43.9	1,732	41.1	89.7
現金及び預金	813		620		
受取手形 売掛金	521		641		
たな卸資産	481		404		
その他	114		66		
固定資産	2,466	56.1	2,478	58.9	100.5
有形固定資産	2,154		2,215		
無形固定資産	195		171		
投資その他の資産	117		92		
資産合計	4,398	100.0	4,211	100.0	95.8
流動負債	1,921	43.7	1,945	46.2	101.2
支払手形 買掛金	328		401		
借入金	1,361		1,282		
その他	231		261		
固定負債	810	18.4	659	15.6	81.4
借入金	743		487		
その他	67		171		
負債合計	2,732	62.1	2,604	61.8	95.3
株主資本	1,787	40.7	1,705	40.5	95.4
資本金	729		729		
資本剰余金	649		649		
利益剰余金	508		425		
自己株式	▲ 99		▲ 99		
評価・換算差額等	▲ 125		▲ 106		
為替換算差額調整	▲ 125		▲ 106		
純資産合計	1,665	37.9	1,606	38.2	96.5
負債純資産合計	4,398	100.0	4,211	100.0	95.8
有利子負債	2,104		1,769		

借入れの返済に伴い、「現金及び預金」の減少

半導体資材 設備稼働により「有形固定資産」の増加

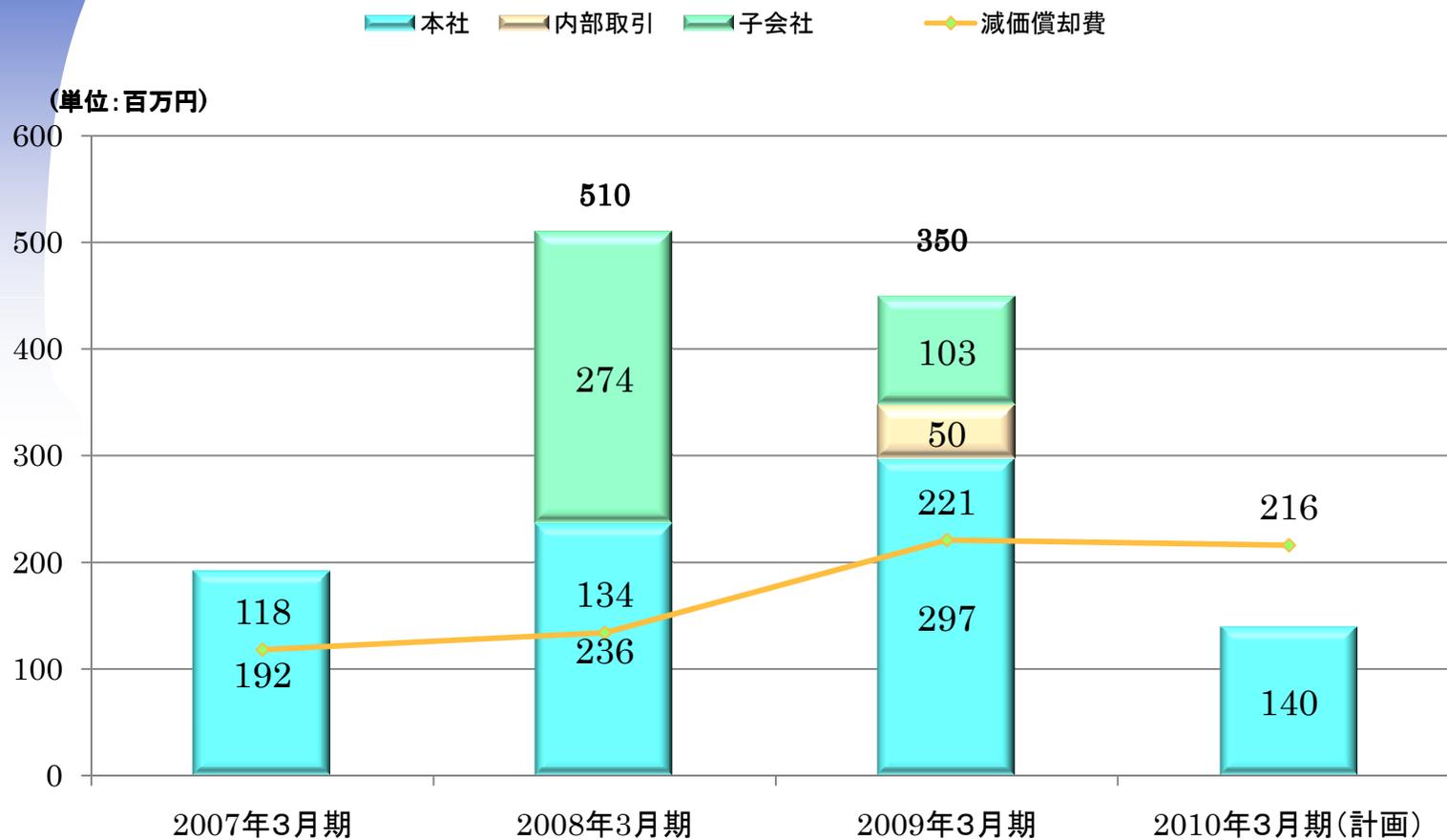
- ・ 営業CF 償却費 126百万円(減価償却費・のれん償却費)
- ・ 投資CF 有形固定資産の売却 101百万円、取得△125百万円
- ・ 財務CF 借入れの返済 △334百万円、配当支払 △33百万円

(単位:百万円)

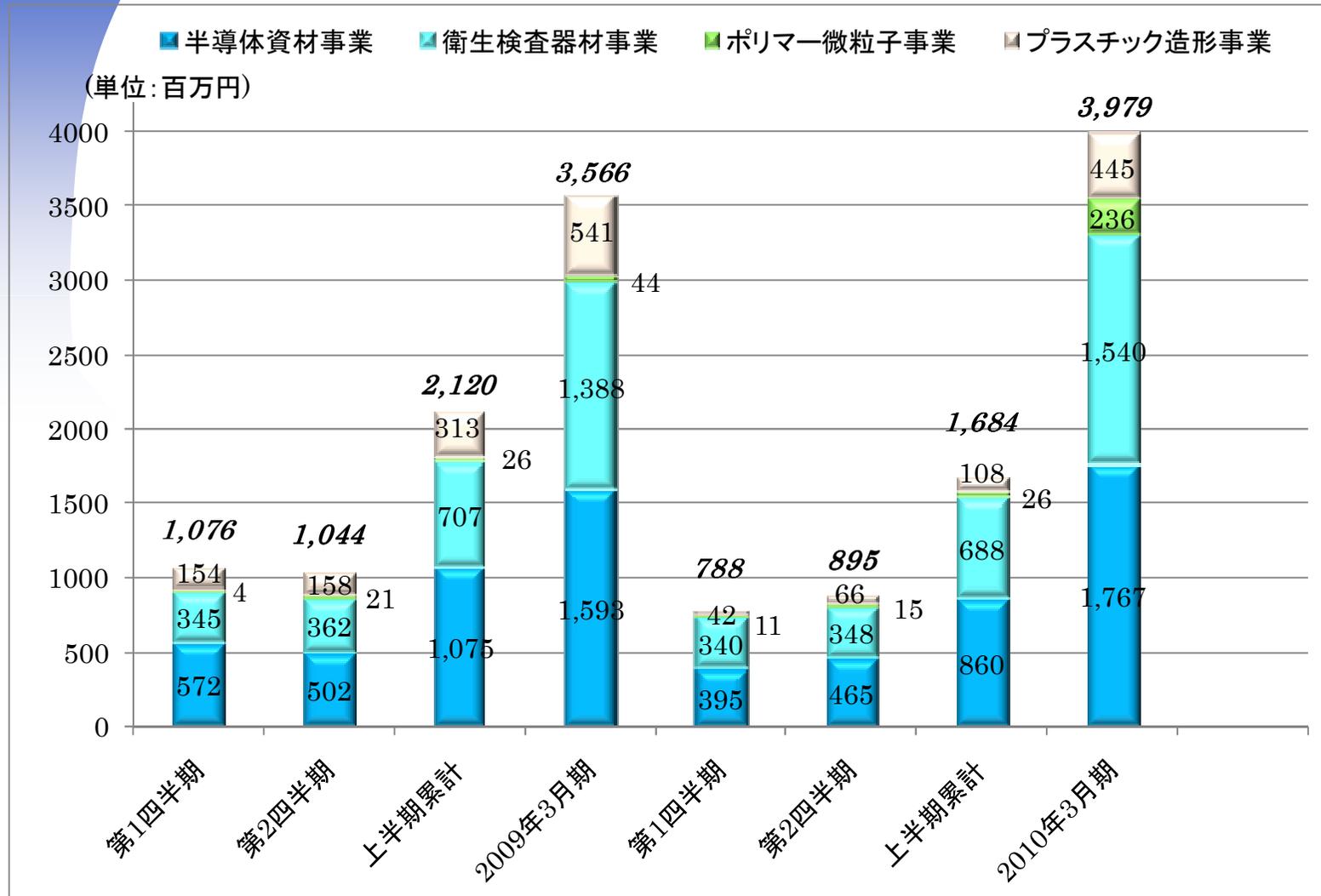
	2009年3月期 第2四半期 (連結)	2010年3月期 第2四半期 (連結)	2009年3月期 会計年度 (連結)
営業活動によるCF	23	228	15
投資活動によるCF	△ 54	△ 36	△202
財務活動によるCF	86	△ 389	663
期末残高	401	620	813

*会計監査前の概算値

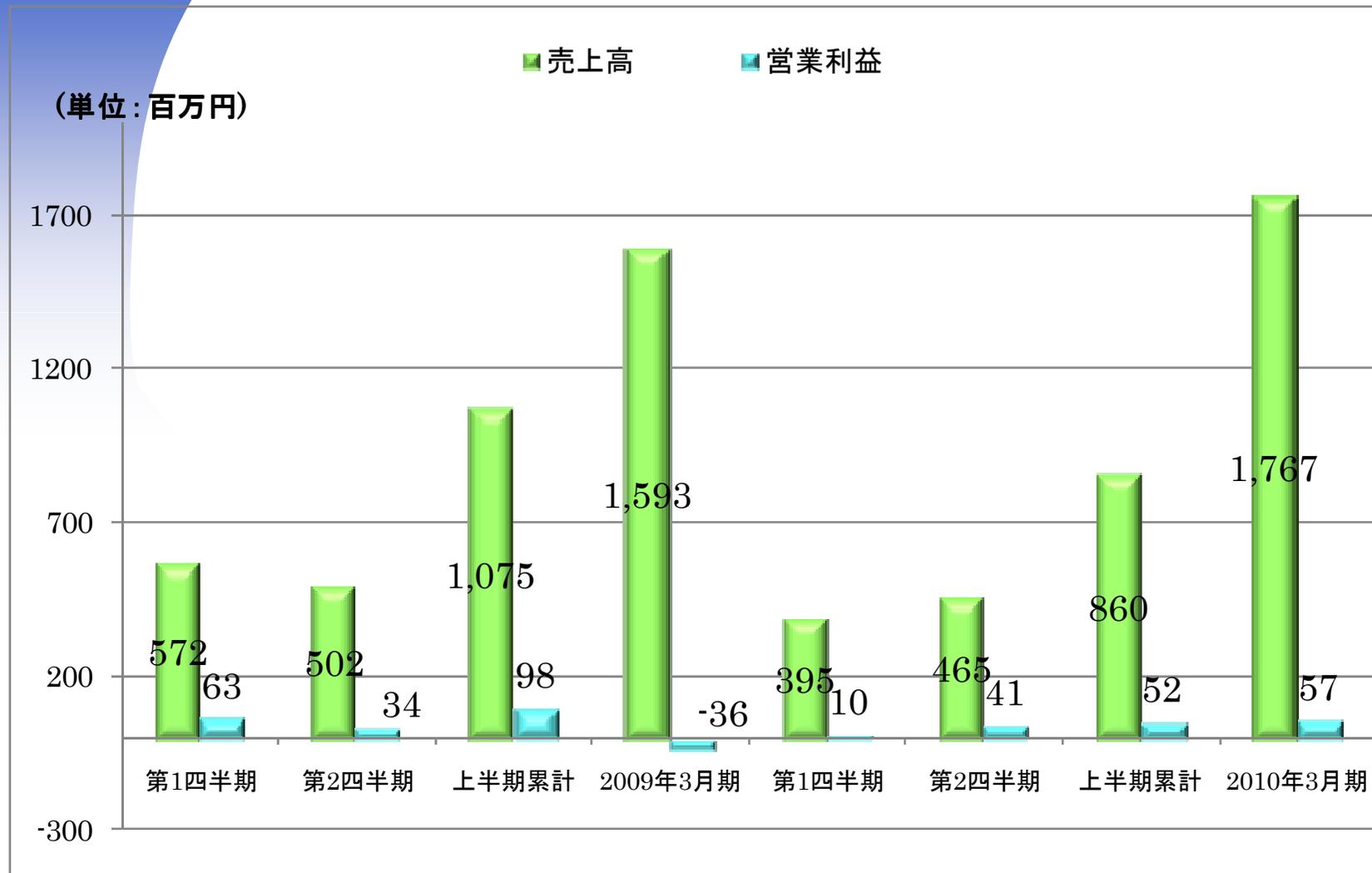
・ 本社 → 工場集約化に伴う設備投資、新規事業向けの投資等。



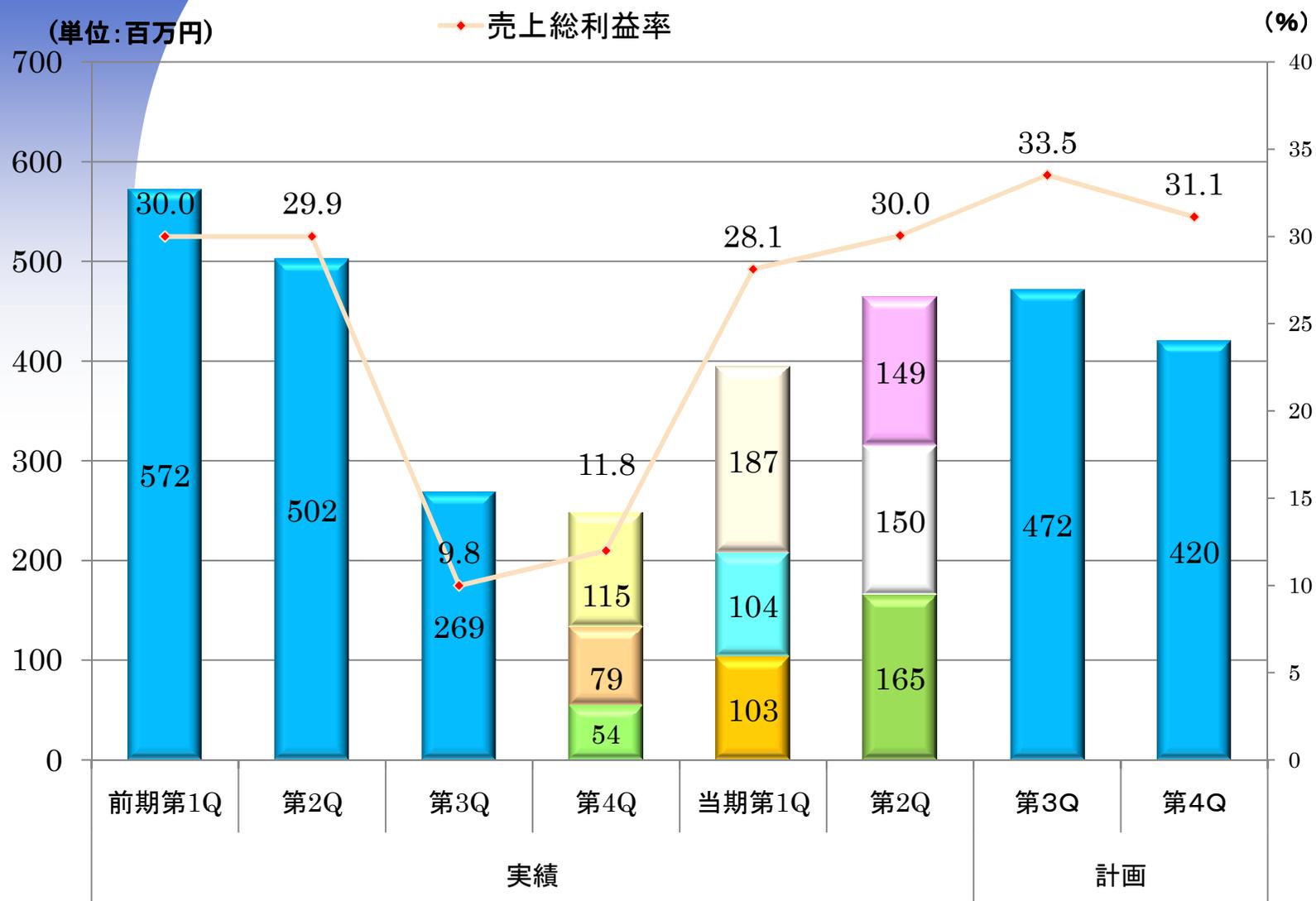
半導体産業全体が回復傾向にある。

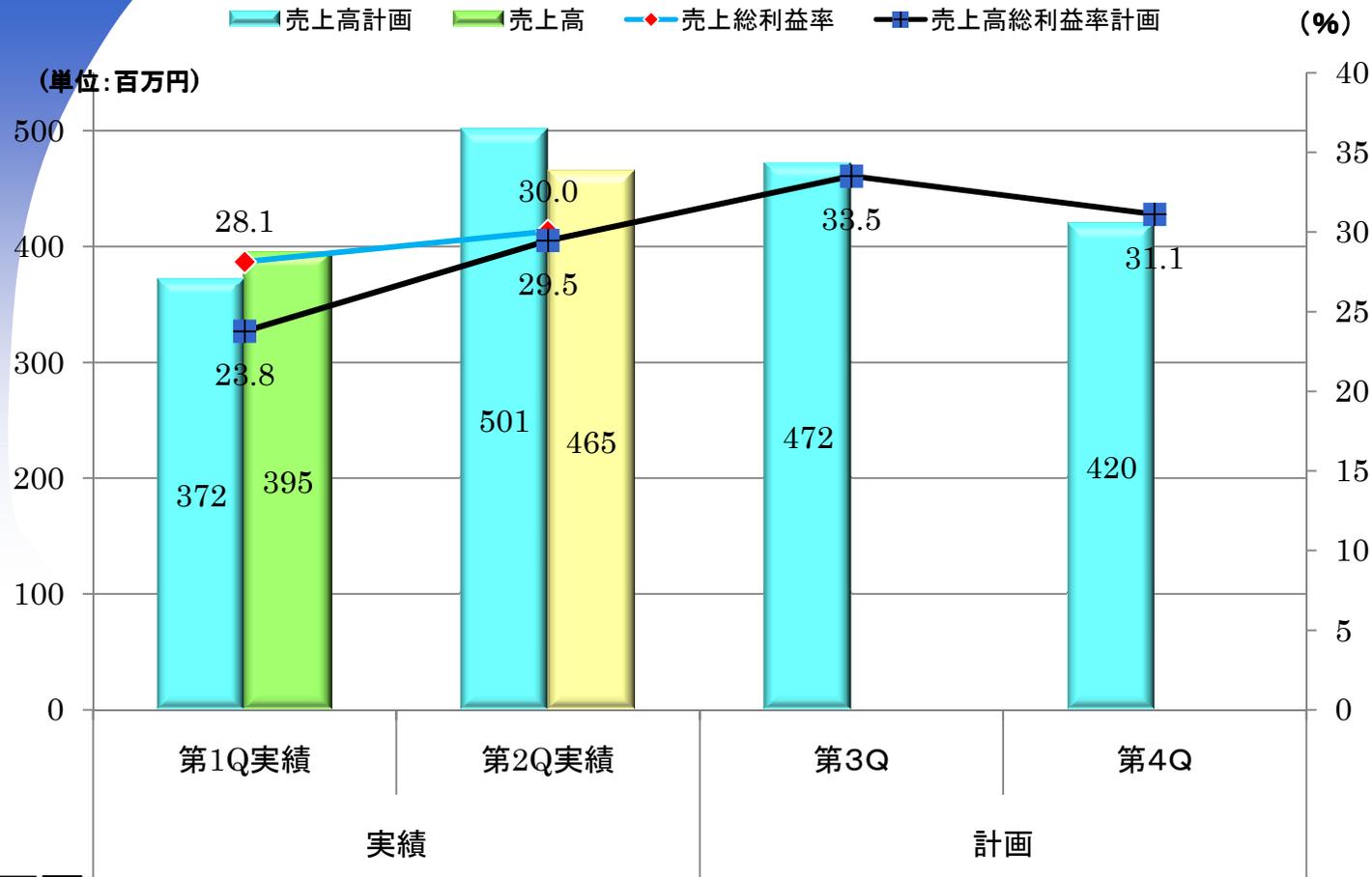


● 6月以降、売上高が安定的に推移 ● 原材料の調達ルート変更によるコストダウン



当第1四半期6月度より、フラットパネルディスプレイ市場の回復により売上高が急回復。

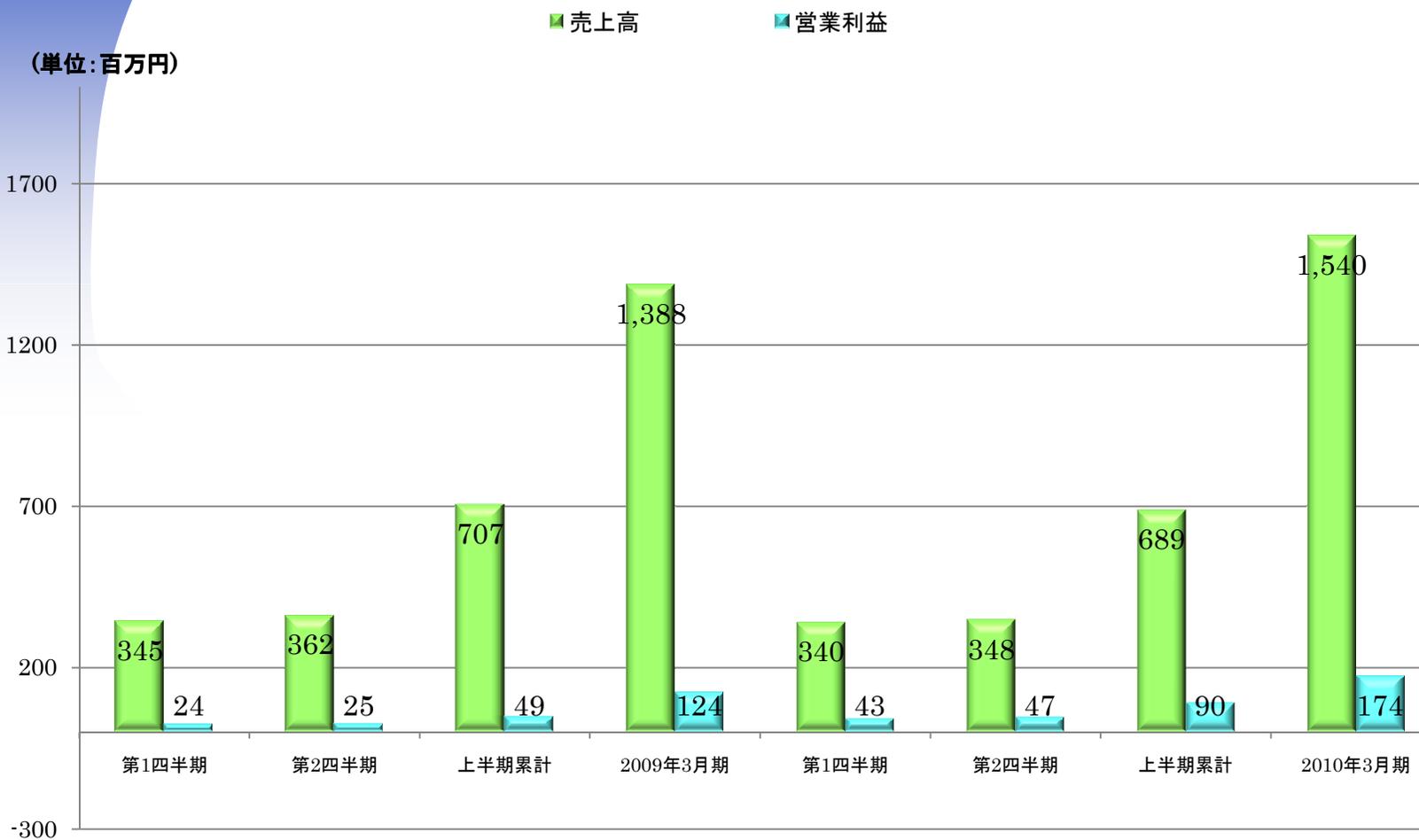




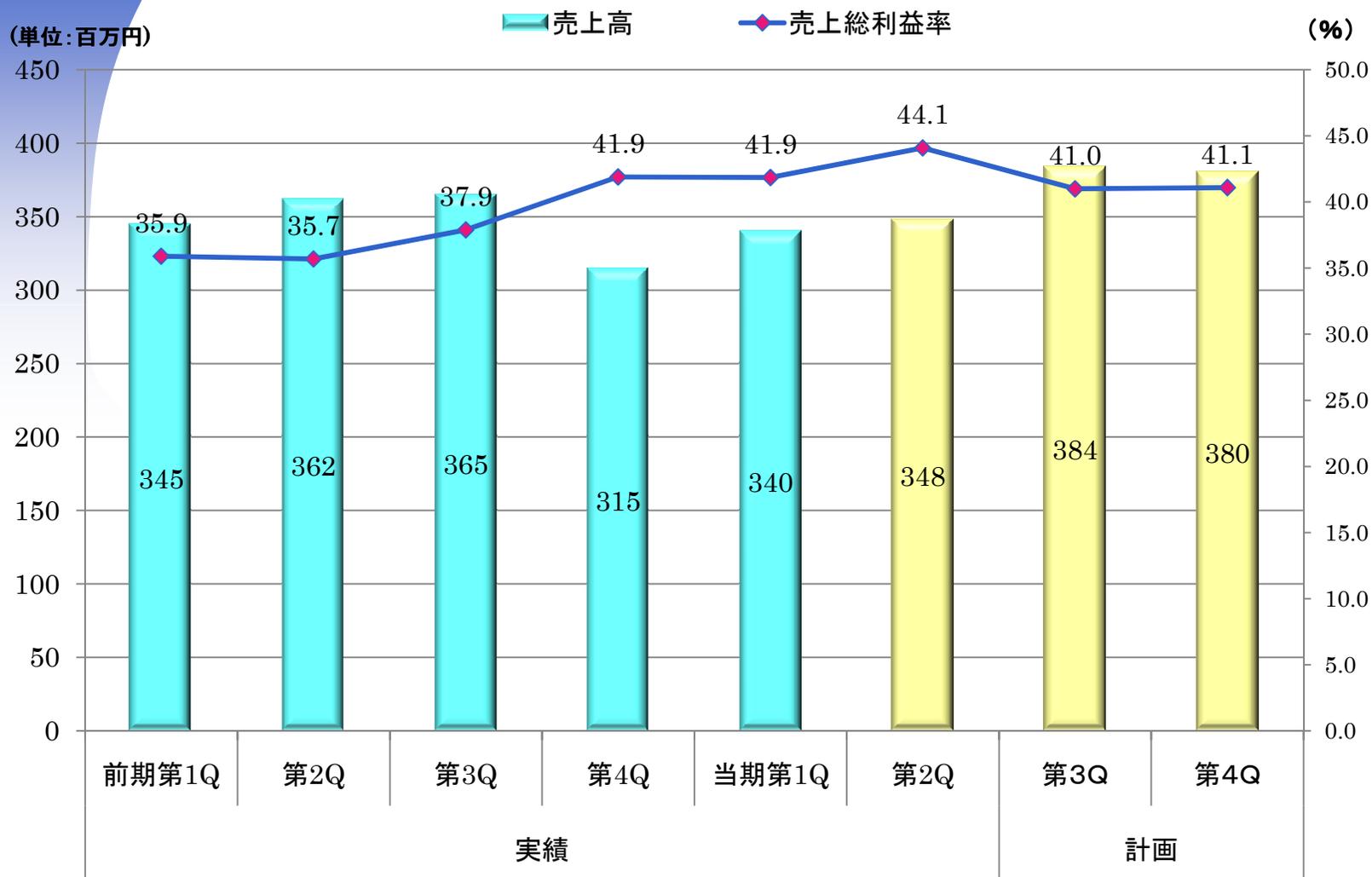
差異要因

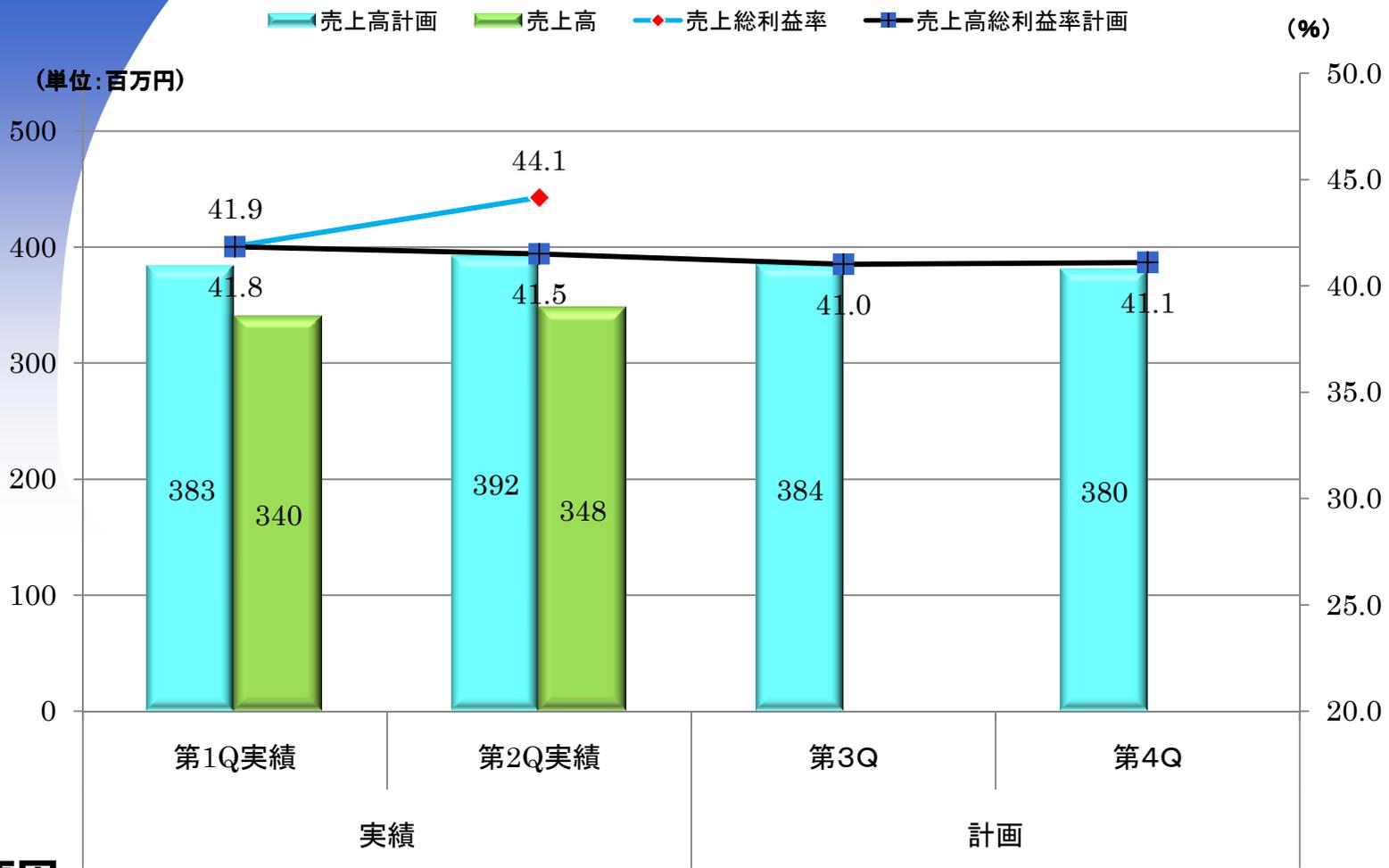
- ◆ 中国TV市場の活況を背景としたフラットパネル市場の回復により、6月度以降も売上高が安定的に推移。
- ◆ 工場の稼働率向上による利益率の上昇。

●新規顧客の獲得、売上、営業利益ともに順調に推移



売上高は前年並みに推移している。

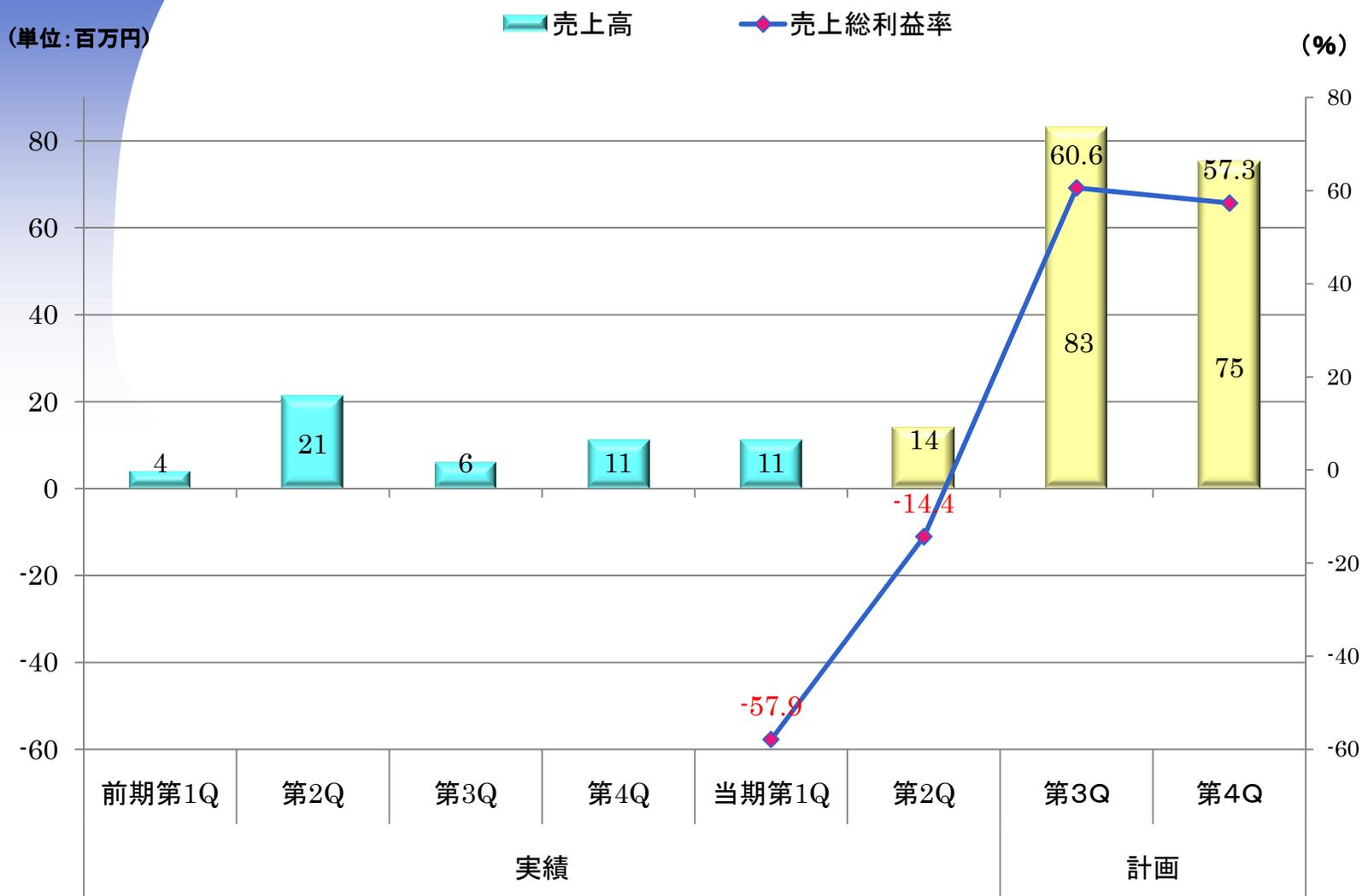




差異要因

◆ 利益率は原材料価格が安定したことにより計画どおり。

- 自動車業界の開発の見送り
- 半導体関連素材メーカーとの製品開発推進



第2部

atect

配当政策

**2009年3月期の配当を実施
一株あたり10円(2009年6月23日)**

今後の中間配当実施を引き続き検討

第3部

atect

参考資料

1. 半導体資材事業

(1) 韓国ウォン安を背景にしたコスト圧縮

PETフィルム、コーティング工程、成形工程の最適配置

(2) 開発案件

導電性ポリマーをベースにしたインク開発

2. 衛生検査器材事業

(1) シャーレ製造工程の革新

3. プラスチック造形事業

(1) PIM部品の量産化

(2) 検査装置の受注

4. ポリマー微粒子事業

(1) トライアル・・・期間損益黒字化に向けた事業体制の見直し

(2) PIM用バインダーの開発・量産開始

台湾、韓国のPIM事業者に販売を開始

ヨーロッパ市場に向けて展示会に出展

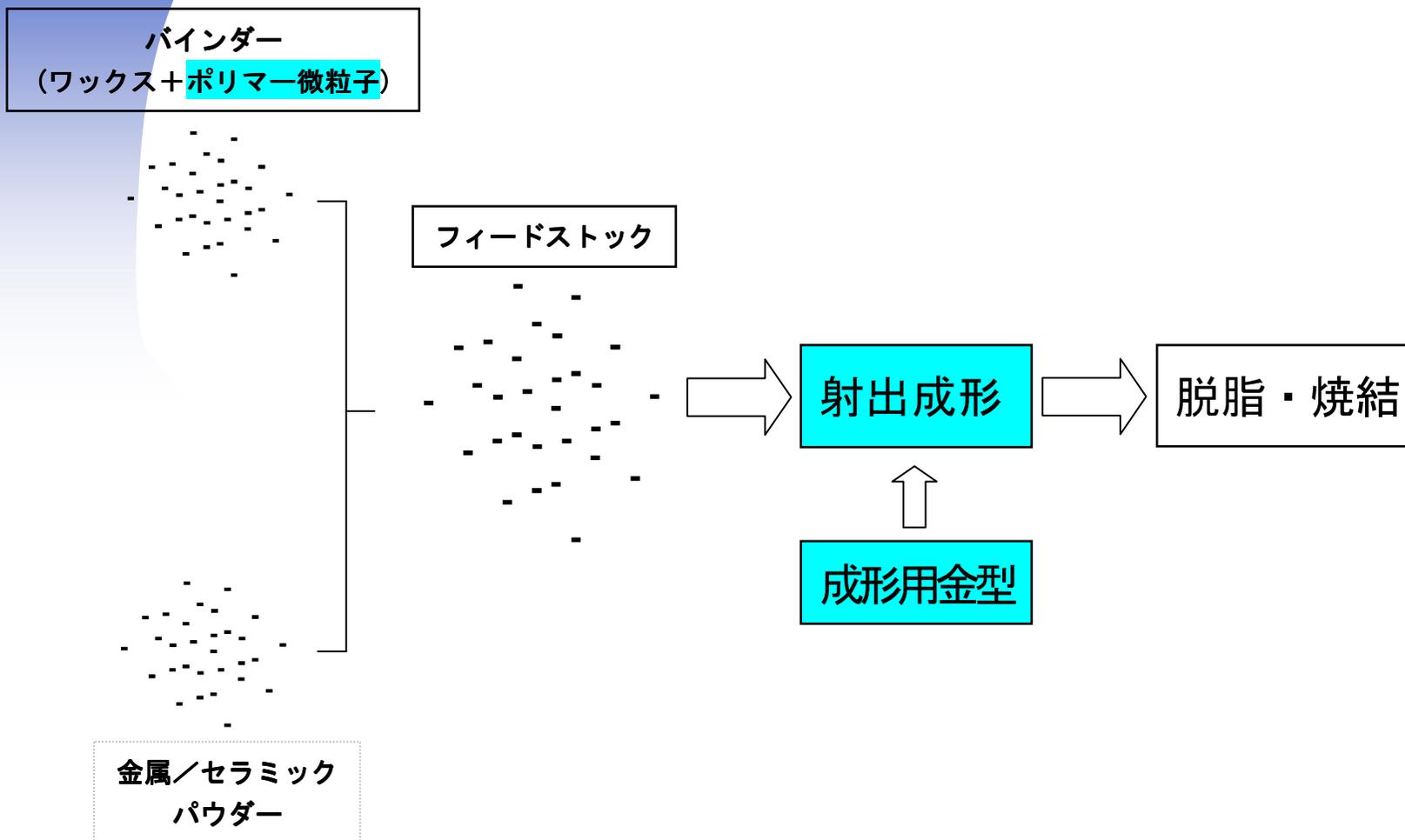
- PIMとは

Powder Injection Moldingの略。粉末射出成形を指す。

金属又はセラミックス粉末と樹脂およびワックスなどからなる バインダーを混合・混練したフィードストックを、金型内に射出成形し、バインダーを脱脂・焼結して金属又はセラミックス製品を製造する技術。(次ページ図参照)

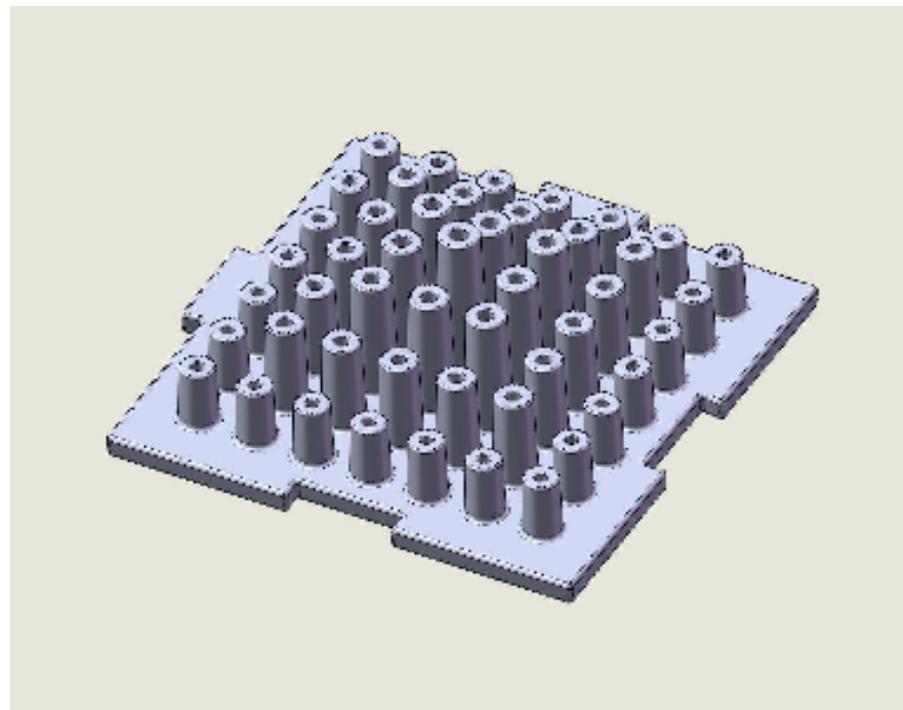
PIMの特性である超耐熱性と超高硬度を最大限に活用できる分野に製品を供給してまいります。

PIM (Powder Injection Mold)の流れ



製品紹介

- ターボチャージャー用ローター
- LED照明用ヒートシンク



年月日	IRイベント	
2009年4月30日	2009年3月期決算発表	済
2009年5月12日	2009年3月期決算説明会	済
2009年6月23日	第40期定時株主総会	済
2009年7月31日	2010年3月期第1四半期業績開示	済
2009年8月4日	2010年3月期第1四半期決算説明会	済
2009年10月30日	2010年3月期第2四半期業績開示	済
2009年11月6日	2010年3月期第2四半期決算説明会	済
2010年1月29日	2010年3月期第3四半期業績開示	

当資料に掲載されている業績見通し、その他今後の予測・戦略などに関する情報は、当資料の作成時点において、当社が合理的に入手可能な情報に基づき、通常予測し得る範囲内で行った判断に基づくものです。

しかしながら実際には、通常予測し得ないような特別事情の発生または通常予測し得ないような結果の発生などにより、当資料記載の業績見通しとは異なる結果を生じ得るリスクを含んでおります。

当社は、投資家の皆様にとって重要と考えられるような情報について、その積極的な開示に努めてまいります。が、当資料記載の業績見通しのみを全面的に依拠してご判断されることはくれぐれもお控えになられるようお願いいたします。

なお、いかなる目的であれ、当資料を無断で複製、転送等をおこなわれぬようお願いいたします。

本資料に関するお問い合わせ

株式会社アテクト 管理ディヴィジョン IR担当

TEL : 072-967-7000

E-mail : ir@atect.co.jp